

ПОЛЮС БАС

**Установка монтажа кристаллов на
подложку методом клеевого
соединения HAD812-PLUS**

**Техническая
информация**

Установка монтажа кристаллов на подложку методом клеевого соединения HAD812-PLUS

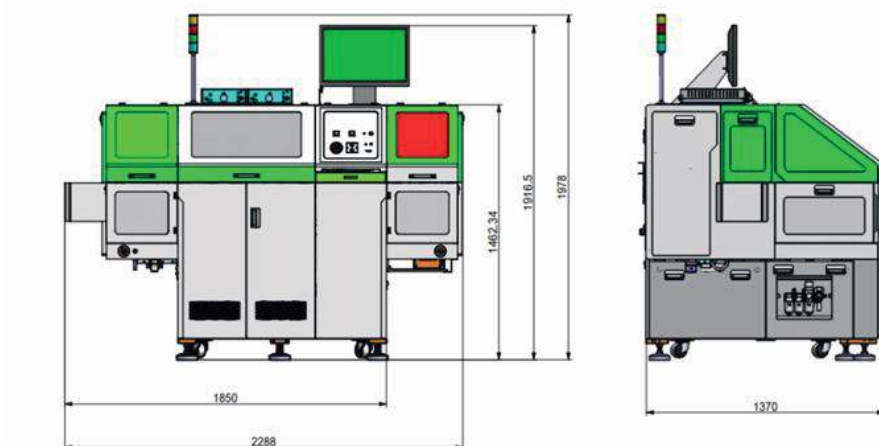


Процесс автоматического высокоскоростного монтажа кристаллов методом клеевого соединения заключается в следующем: выводная рамка загружается во входной модуль, затем она поднимается и переносится на рабочий столик по транспортировочной направляющей, на ее поверхность наносится клей с помощью системы дозирования. Затем полупроводниковая пластина с кристаллами (чипами) забирается поворотным рычагом из расширительного кольца и приклеивается к выводной рамке. По окончании процесса склеенная выводная рамка загружается в контейнер ожидания на выходном подъемном столе.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точный контроль процесса приклеивания обеспечивает стабильные и высококачественные результаты монтажа пластин (чипов);
- Надежная конструкция и удобное программное обеспечение делают установку высокопроизводительной и эффективной;
- Система состоит из нескольких модулей, которые включают в себя подъемный стол загрузки/выгрузки, консоль для пластин (чипов), рабочий столик с направляющими, компоненты монтажной головки и дозирования клея;
- Сфера применения установки - упаковка полупроводников.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип обрабатываемых кристаллов	DFN, QFN, SOP, SSOP, SOT и т.д.
Габаритные размеры, мм	1370 x 2288 x 1978
Масса, кг	1500
Потребляемая мощность, кВт	1,3
Рабочее напряжение, В 220 (переменный ток 50Гц)	Рабочее напряжение, В 220 (переменный ток 50Гц)
Точность позиционирования, мкм ± 20	Точность позиционирования, мкм ± 20
Точность вращения, $^{\circ} \pm 1$	Точность вращения, $^{\circ} \pm 1$
Налипание клеевого слоя, %	≤ 75 от толщины пластины (при толщине пластины > 150 мкм)
Толщина линии склеивания, мкм	10-50 (при СРК $\geq 1,67$)
Смещение, мкм	< 25 (при СРК $\geq 1,67$)
Площадь одиночных пустот, %	≤ 2 (суммарная площадь всех пустот $\leq 5\%$)
Наработка на отказ (MTBF), ч	≥ 168 (MTBA ≥ 1 ч)
Площадь обработки, мм ²	0,38 – 6 (15mil ² -236mil ²)
Угол вращения, $^{\circ}$	± 180
Диаметр загружаемых пластин, дюймы	8-12
Разрешение, мкм	1
Сила клеевого соединения, г	30 - 300
Макс. перемещение по оси Z, мм	3
Система визуального контроля	цветность: 256 градаций серого, разрешение: 720 x 540



	пикселей, точность визуализации: $\pm 0,025$ mil на 50mil
Длина выводной рамки, мм	110 - 300
Ширина выводной рамки, мм	25 - 110
Толщина подложки, мм	0,12 – 0,76

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru